



華立 Q1 營收、毛利同創史上新高

2026.05.12 高科技材料及設備供應商華立（3010）公布 2026 年第一季財報，在人工智慧應用快速擴展，AI 伺服器、高效能運算及先進半導體需求熱度全面攀升，帶動半導體與電子材料供應鏈強勁成長，三率同步提升，交出亮眼成績。第一季營收 218.4 億元，創歷史新高，年增 17.4%；受惠產品組合優化，毛利達 17.8 億元，年增 27.7%，續創單季新高；在費用控管得宜下，營業淨利 8.4 億元，年增 53.3%，為歷史次高；每股盈餘 2.47 元，年增 27.3%。

華立在半導體與 PCB 雙引擎帶動下，4 月營收一舉突破 80 億元，創歷年單月新高。隨著客戶訂單動能強勁、持續擴充產能，加上原材料價格走升，法人看好公司營運動能續強，全年業績有望維持高檔表現。

近年華立透過購併與合資策略，持續強化供應鏈穩定性，並與日本光阻大廠 JSR 於雲林設立合資工廠，共同布局先進電子材料製造。生產品項涵蓋最先進半導體光阻劑，藉由產能擴充解決供不應求的市況，同步推動關鍵材料在地化生產，進一步提升台灣半導體供應鏈韌性。

在地緣政治與供應鏈重組趨勢下，此布局可有效回應客戶在地化需求，強化長期合作關係，同時縮短交期、降低運輸成本並減少碳排放，兼顧供應鏈效率與永續發展，創造多方共贏局面。

JSR 在台啟用「先進平坦化製程解決方案聯合研究中心」，打造專注 CMP（化學機械平坦化）研磨液研發、測試與驗證的頂級實驗室。該中心鎖定先進製程需求，強化材料評估與技術服務能力。透過原廠研發能量在地化，華立身為關鍵通路商，得以更即時掌握客戶需求、深化與供應商協同合作，進一步提升整體服務附加價值。

主力客戶受 AI 伺服器與高效能運算（HPC）晶片需求帶動，ABF 載板市場供需持續緊俏，產業邁入高成長循環。外資法人預估，ABF 載板供需缺口將一路延續至 2028 年，而高階載板所需的關鍵材料乾膜供不應求，華立與原廠在台合資的工廠已完成擴產，待客戶認證通過後，下半年新產能即能進入市場，緩解供給缺口。隨著新一代 AI 晶片朝向大尺寸封裝與高層數設計演進，加上 AI NPU/GPU、HBM 及 ASIC 等應用快速擴展，帶動高階載板材料需求明顯增加。華立銷售之高解析度乾膜，已切入多家指標客戶供應鏈並取得主要訂單，相關產品營收維持高雙位數成長。

在 PCB 市場方面，華立除切入 AI 伺服器板與光模塊通訊板應用外，也積極布局低軌衛星領域。客戶為全球低軌衛星 PCB 板龍頭供應商，主要供應國際指標衛星營運商地面接收站設備。由於衛星用電路板須具備耐高低溫、抗震動及長時間穩定運作能力，對材料與製程要求嚴格，華立銷售之高解析度乾膜已進入核心供應鏈。隨客戶擴增泰國產能，華立同步深化東南亞布局；在全球低軌衛星建置與資本支出增加下，相關材



料需求持續攀升，成為重要成長動能之一。

另一方面，全球雲端服務業者（CSP）持續擴大 AI 基礎建設投資，使 AI 訓練與推論所需高階晶片需求快速增加，高階銅箔基板（CCL）市場供不應求。華立在原廠全力支持下，攻入全球領先伺服器及網通 PCB 製造商供應鏈，終端客戶涵蓋多家國際大型 CSP 業者。主力客戶聚焦高層數、高技術密度 PCB 產品，可滿足低損耗、高速傳輸等高規要求。在 AI 伺服器及 800G 交換器需求強勁，以及上游玻纖布與銅箔原料價格走揚，推升高階 CCL 價格上漲；在價量齊揚及訂單滿載帶動下，第一季銅箔基板營收呈現逾倍數成長。

隨著 AI 伺服器、高階載板與高速運算應用快速擴張，PCB 設備市場需求同步升溫，曝光機、鑽孔機、檢查機，以及乾、濕製程整體解決方案，皆成為 PCB 廠積極擴產的核心採購項目。受惠於市場強勁需求，華立於上述四大設備領域的產品與服務業績均呈現大幅增長。



關於華立企業：本公司成立於 1968 年，配合我國工業發展與整體企業營運需求，先後引進複合材料、資訊/通訊、印刷電路板、半導體、平面顯示器、以及綠能光電產業材料與設備，以致力成為大中華地區提供高科技材料、設備與技術的全方位科技服務廠商。華立企業總公司位於高雄，先後於中國大陸、新加坡、韓國等重要城市設立銷售據點。

新聞聯絡人：

呂淑甄

投資人關係

華立企業股份有限公司

Tel. +886-7-2164311, ext. 27093

Email : jessica@wahlee.com

Website : www.wahlee.com